

国泰君安证券股份有限公司
关于锦州神工半导体股份有限公司
2024年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的规定与要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”和“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责神工股份上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。本持续督导半年度跟踪报告释义与公司2024年半年度报告一致。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与神工股份签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所报告并经上海证券交易所审核后予以披露	2024年上半年，神工股份在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应当自发现或应当发现之日起五个交易日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2024年上半年，神工股份在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，持续关注神工股份的生产经营、信息披露情况

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的各项承诺	2024年上半年持续督导期间，神工股份董事、监事、高级管理人员无违法违规和违背承诺的情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促神工股份依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对神工股份的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，神工股份的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	神工股份已按照证券监管部门的相关要求建立了信息披露制度。经核查，神工股份向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应当及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应当及时向上海证券交易所报告	保荐机构对神工股份的信息披露文件进行了审阅，不存在应当及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2024年上半年，神工股份及其主要股东、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应当及时向上海证券交易所报告	2024年上半年，神工股份及其主要股东不存在未履行承诺的情况
13	关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应当及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应当及时向上海证券交易所报告	2024年上半年，经保荐机构核查，不存在应当及时向上海证券交易所报告的情况

序号	工作内容	持续督导情况
14	发现以下情形之一的，应当督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2024年上半年，神工股份及相关主体未出现该等事项
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查： （一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2024年上半年，神工股份及其相关主体未出现该等情况

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）客户集中风险

大直径硅材料产品是公司收入的主要来源。单晶硅材料行业具有进入门槛高、细分行业市场参与者较少等典型特征。公司主要客户包括三菱材料、SK 化学等境内外企业，主要分布在中国、韩国、日本等国家和地区，客户集中度较高，存在客户集中风险。如公司下游主要客户的经营状况或业务结构发生重大变化并在未来减少对公司产品的采购，或出现主要客户流失的情形，公司经营业绩存在下滑的风险。

（二）供应商集中风险

公司生产用原材料主要为高纯度多晶硅、高纯度石英坩埚和石墨件等，其中高纯度多晶硅的终端供应商主要为瓦克化学，高纯度石英坩埚的主要供应商为SUMCO JSQ，尽管公司已经开始根据下游客户需求进行原材料国产化，但公司

高纯度多晶硅和高纯度石英坩埚的采购渠道仍较为单一，采购集中度较高。如果公司主要供应商交付能力下降，公司原材料供应的稳定性、及时性和价格均可能发生不利变化，从而对公司的生产经营产生不利影响。

（三）原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料为高纯度多晶硅、高纯度石英坩埚和石墨件等，原材料成本占公司主营业务成本的比重较高，主要原材料价格的变化直接影响公司的利润水平。如果未来原材料价格大幅度上涨，且公司主要产品销售价格不能同步上调，将对公司的盈利能力产生不利影响。

同时，公司采购的多晶硅原材料纯度通常为 8 个 9 以上，公司生产并销售的集成电路刻蚀用单晶硅材料产品纯度主要为 10 个 9 以上。纯度是公司产品的重要参数指标之一，从纯度参数看公司产品与原材料的纯度差异较小，约为 1-2 个数量级；如果公司采购的原材料质量不稳定，可能对公司产品品质产生一定不利影响。

（四）业务波动及下滑风险

公司的大直径硅材料产品主要向下游集成电路刻蚀用零部件制造商销售。此类制造商对公司产品进行精密机械加工形成硅零部件产品，最终销售给等离子刻蚀机制造商或直接向集成电路制造厂商销售。

部分规模较大的硅零部件生产商除具备机械加工能力外，仍自行保有一定规模的大直径单晶硅材料生产能力。在行业上升周期，主要客户对单晶硅材料的增量需求主要通过外购满足，而在行业下行周期，主要客户因具备一定的大直径单晶硅材料生产能力，外购单晶硅材料的规模可能下降。因此，公司作为行业内主要的大直径单晶硅材料生产企业，在行业下行周期中可能面临较高的业务波动风险。

同时，报告期内公司产品主要向中国大陆、韩国、日本销售，半导体国产化进程及全球半导体产业景气恢复对公司业绩带来一定积极影响，但公司下游客户采购计划的调整相比行业景气度恢复具有一定的滞后性，且半导体行业属于周期性行业，行业整体需求受全球地缘政治冲突等影响仍存在不确定性。

公司硅零部件和半导体大尺寸硅片产品，面向半导体等离子刻蚀机设备厂商和集成电路制造商销售。考虑到半导体行业景气度通过影响存量芯片生产线的产能利用率以及芯片生产线的新增投资水平，最终影响等离子刻蚀机硅零部件产品和半导体大尺寸硅片市场需求，因此公司以上两种新产品的销售前景与半导体行业景气度相关，在行业下行周期中同样可能面临一定的业务波动风险。

（五）市场开拓及竞争风险

公司大直径硅材料产品的现有客户包括三菱材料、SK 化学、CoorsTek、Hana 等半导体材料行业企业；硅零部件产品下游客户为国内等离子刻蚀机制造厂商和国内集成电路制造厂商，前者如北方华创、中微公司，后者如长江存储、福建晋华等公司；半导体 8 英寸轻掺低缺陷抛光硅片的目标客户群体为国内外集成电路制造商，主要包括台湾积体电路制造股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司等企业。因此，公司大直径硅材料产品既有客户与硅零部件产品、半导体大尺寸硅片产品的目标客户并不重叠，公司拓展下游客户存在一定难度和不确定性；同时半导体 8 英寸轻掺低缺陷抛光硅片所在细分市场的市场集中度较高，新进入者面临的市场竞争较为激烈。如果公司不能成功开发半导体 8 英寸轻掺低缺陷抛光硅片或开发进度不及预期，则可能拉长前期技术投入的回报期或无法有效应对市场竞争，将会对公司未来经营业绩产生不利影响。

（六）毛利率下滑风险

近年来下游市场需求和行业竞争格局不断变化，未来随着公司刻蚀用多晶硅材料销售规模的扩大以及募投项目建成后新增设备折旧的计提，若公司不能持续推出具有市场竞争力的优质产品，并通过提高生产效率、技术创新、规模效应等方式降低生产成本，则可能面临大直径硅材料业务毛利率进一步下滑的风险。

（七）行业风险

半导体行业属于周期性行业，行业增速与科技发展、全球经济形势高度相关。此外，半导体行业的周期性还受技术升级、市场结构变化、应用领域升级、自身库存变化等因素的影响。近年来，半导体行业研发周期不断缩短，新技术、新工艺的不断应用导致半导体产品的生命周期不断缩短，对公司的技术优势产生影响。

2024年，中美贸易摩擦仍然存在，全球性公共安全危机仍在对半导体产业链生产端造成负面影响，加之全球地缘政治军事冲突爆发等因素推高全球通胀水平，消费者信心受挫导致下游终端需求萎缩，全球半导体行业目前处于调整期。未来若中美贸易摩擦进一步升级、半导体产业景气度下滑，公司的生产运营可能受到影响。

（八）宏观环境风险

全球范围内主要等离子刻蚀机生产厂商和刻蚀用硅电极制造厂商位于日本、韩国和美国，公司大直径硅材料产品亦主要出口上述国家，公司海外销售比例较高。如未来相关国家在贸易政策、关税等方面对我国设置壁垒或汇率发生不利变化，且公司不能采取有效措施降低成本、提升产品竞争力，将导致公司产品失去竞争优势，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（九）其他重大风险

1、募集资金投资项目建设风险

公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”涉及土建及机电工程、设备采购、设备安装调试等环节。前述募集资金投资项目在实施过程中可能受到工程施工进度、工程管理、设备采购、设备调试及人员配置等因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性，募集资金投资项目存在不能按期竣工投产的风险。

2、新增折旧摊销影响公司盈利能力风险

根据公司募集资金使用计划，募集资金投资项目建成后，公司资产规模将有所增加，从而导致公司年折旧及摊销成本费用增加。若募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产和无形资产投资带来的折旧和摊销，将在一定程度上影响公司净利润和净资产收益率水平。

四、重大违规事项

2024年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年上半年，公司主要财务数据如下所示：

主要会计数据	2024 年上半年	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业收入 (元)	125,219,876.76	78,834,823.43	58.84
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,762,100.10	-23,699,446.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,893,909.04	-25,668,061.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额 (元)	78,368,987.09	37,877,267.51	106.90
主要会计数据	2024 年 6 月末	上年度末	增减变动幅度 (%)
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,756,277,546.04	1,761,794,579.03	-0.31
总资产 (元)	1,942,298,211.13	1,933,422,436.15	0.46

2024 年上半年，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2024 年上半年	上年同期	增减变动幅度 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.03	-0.15	不适用
稀释每股收益 (元 / 股)	0.03	-0.15	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.02	-0.16	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.27	-1.52	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.22	-1.65	不适用
研发投入占营业收入的比例 (%)	9.84	17.26	减少 7.42 个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

公司 2024 年上半年实现营业收入 12,521.99 万元，同比增加 58.84%，主要系半导体行业周期回暖、公司订单增加所致；公司 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 476.21 万元，同比增加，主要系营业收入增加所致；公司 2024 年上半年经营活动产生的现金流量净额同比增加 106.90%，主要系营业收入增加导致回款增加等因素所致。

综上，公司 2024 年上半年主要财务数据及指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

经过多年积累，公司形成了较强的技术、质量、客户、销售服务、细分行业方面的领先优势，具体如下：

（一）技术优势

自成立以来，公司一直专注于大直径硅材料及其应用产品的研发、生产与销售，突破并优化了多项关键技术，构建了较高的技术壁垒。公司凭借无磁场大直径单晶硅制造技术、固液共存界面控制技术、热场尺寸优化工艺等多项业内领先的工艺或技术，在维持较高良率和参数一致性水平的基础上有效降低了单位生产成本。报告期内，公司在 CVD-SiC 技术领域研发取得了“快速 CVD-SiC 技术”，公司的高通量工艺气体进气系统可以长时间维持大流量甲基三氯硅烷的进气稳定性，从而保证 SiC 在基体表面的持续快速生长。

（二）质量优势

目前公司已经建立符合国际标准的质量控制和品质保证体系，并严格按照 ISO9001 质量管理体系认证的相关标准，在产品的设计开发、原材料采购、产品生产、出入库检验、销售服务等过程中严格实施标准化管理和控制，实施精益生产，使产品质量得到巩固和提升。公司持续通过艰苦的努力，规范和提高生产各个环节的标准化。

（三）客户优势

公司下游客户对合格供应商的认证程序十分严格，认证周期较长，认证程序复杂。凭借较高良品率和参数一致性水平、持续稳定的产品供应能力，公司在集成电路刻蚀用的大直径硅材料领域树立了良好的口碑，并与海外客户建立了稳固的商业合作伙伴关系。公司产品直接销售给日本、韩国等半导体强国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备原厂，例如美国泛林集团(Lam Research)和日本东电电子(Tokyo Electron Limited, TEL)，并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商。公司硅零部件产品已经进入北方华创、中微公司等中国本土等离子刻蚀机制造厂商和长江存储、福建晋华等本土一流存储

类集成电路制造厂商；半导体大尺寸硅片产品已经定期供货给日本某集成电路制造厂商。

（四）销售服务优势

公司建立了覆盖海内外的系统销售服务体系，持续完善覆盖日本、韩国客户的服务网络，并建立了兼具广度和深度的国内销售网络，覆盖了国内主流刻蚀机原厂以及行业主流集成电路制造厂商，能够提供及时可靠的售前和售后服务。

公司成立了由管理层负责的专业销售团队。通过定期及不定期拜访客户，能够快速、准确地理解客户的个性化需求，并及时获取行业技术发展动态及市场信息。公司在客户需求的响应速度、产品供货速度、持续服务能力等方面均表现良好，形成了销售服务优势。

目前，公司泉州、锦州两处硅零部件工厂按需扩产，公司南北两处厂区的布局能够高效完成研发对接，快速响应下游国内等离子刻蚀机生产厂家以及集成电路制造厂商客户自主委托定制改进硅零部件的需求，更好地服务全国客户。

（五）细分行业领先优势

公司自成立以来一直专注于大直径硅材料及其应用产品的生产、研发及销售。凭借多年的积累和布局，公司在大直径硅材料领域继续保持领先地位，掌握了 22 英寸及以下尺寸晶体的所有技术工艺，能够大规模、高品质、高可靠、广覆盖地向全球下游厂商提供大直径硅材料产品，在全球细分领域处于领先地位。

2018 年以来，公司顺应了等离子刻蚀机技术升级所带来的新需求，突破了大直径硅材料领域的诸多技术障碍，长期的品质一致性和成本优势为公司赢得了国际市场份额，并使下游客户对公司产生依赖。

近年来，公司在 16 英寸以上大直径硅材料领域的产能扩张较快，已经确保公司产能大于下游厂商的自有大直径硅材料产能，具有技术和规模双重优势。由于公司下游直接客户硅电极产品的主要应用场景在于终端客户集成电路制造厂商的 12 英寸生产线，而 12 英寸晶圆制造越来越多地采用 16 英寸以上大直径硅材料产品所制成的硅零部件，因此公司具备独特的竞争优势。

在硅零部件领域，公司是国内极少数具备“从晶体生长到硅电极成品”完整

制造能力的一体化厂商。公司硅零部件产品的上游原材料（大直径刻蚀用单晶硅材料）具备稳定性、一致性、便捷性及成本的优势。

报告期内，公司开发的各项技术，能够满足设备原厂不断提升的技术升级要求。在半导体大尺寸硅片领域，评估认证工作取得一定进展，具备了向国内集成电路制造厂商供应高质量硅片的潜在实力。

综上所述，2024年上半年，公司核心竞争力未发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2024年上半年公司研发费用为1,231.86万元，较上年同期减少9.48%，主要系公司研发材料投入减少所致。2024年上半年公司研发投入占营业收入的比例为9.84%，较上年同期减少7.42个百分点。

（二）研发成果

公司持续加强研发投入，报告期内公司在CVD-SiC技术领域研发取得了“快速CVD-SiC技术”，公司的高通量工艺气体进气系统可以长时间维持大流量甲基三氯硅烷的进气稳定性，从而保证SiC在基体表面的持续快速生长。

报告期内，公司新增发明专利申请1个，实用新型专利申请2个，获得实用新型专利9个。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2020年首次公开发行股票

经中国证监会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]100号）核准，公司采用战略配售、网上网下方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股21.67元。截至2020年

2月17日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额866,800,000.00元，扣除承销费、保荐费76,049,433.93元后的790,750,566.07元已于2020年2月17日分别存入公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行0708004329200067771账户300,000,000.00元，存入锦州银行股份有限公司金凌支行410100692121518账户300,000,000.00元，存入锦州农村商业银行股份有限公司营业部392212010160740453账户190,750,566.07元；减除审计费、律师费、信息披露等发行费用15,881,132.08元后，实际募集资金净额为人民币774,869,433.99元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第1-00010文号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2023年向特定对象发行股票

公司于2023年9月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许[2023]2051号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票10,305,736股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为29.11元，募集资金总额为人民币299,999,974.96元，扣除不含税的发行费用人民币3,943,396.22元后，实际募集资金净额为人民币296,056,578.74元。上述资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年9月15日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]110Z0012号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本期使用金额及年末余额

1、2020年首次公开发行股票

截至2024年6月30日，公司募集资金累计用于募投项目支出732,860,809.88元。截至2024年1月，公司“8英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项，结项后的节余募集资金9,068.26万元永久补充流动资金。募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户使用人	存放金额
中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200067771	公司	已注销，零余额
锦州银行股份有限公司金凌支行	410100692121518	公司	已注销，零余额
锦州农村商业银行股份有限公司营业部	392212010160740453	公司	已注销，零余额

2、2023 年向特定对象发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计用于募投项目支出 86,283,063.94 元。公司募集资金实际结余金额为 211,309,192.69 元。募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户使用人	存放金额
招商银行锦州分行营业部	416900037710703	公司	188,882,963.90
中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200669624	公司	22,426,228.79
合计			211,309,192.69

2024 年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2024 年上半年，公司主要股东更多亮照明有限公司、矽康半导体科技（上海）有限公司持股情况如下：

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	期末持股比例	变动原因
更多亮照明有限公司	0	37,003,560	21.73%	不适用
矽康半导体科技（上海）有限公司	0	35,550,301	20.87%	不适用

截至 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份

的情况如下：

姓名	职务	间接持股方式	期末间接持股比例	增减变动原因
潘连胜	董事长、总经理	通过持有矽康 75%的股权间接持有公司股份	15.66%	-
袁欣	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	通过持有矽康 25%的股权、直接及间接持有晶励投资 99.58%的份额、旭捷投资 2.47%的份额间接持有公司股份	6.91%	-
庄坚毅	董事	通过直接及间接持有更多亮 100%的股权间接持有公司股份	21.73%	-
哲凯	监事会主席	通过持有旭捷投资 12.38%的份额间接持有公司股份	0.04%	-
刘晴	监事	通过持有旭捷投资 12.38%的份额间接持有公司股份	0.04%	-
方华	职工代表监事	通过持有旭捷投资 12.38%的份额间接持有公司股份	0.04%	-

2024 年上半年，公司主要股东、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人签字：



姚巍巍



陈海

国泰君安证券股份有限公司

2024年8月16日

